

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

赣州逸豪新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与逸豪新材2023年度业绩说明会议的全体投资者
时间	2024年05月17日（周五）下午14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）及价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）平台采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 张剑萌先生 副总经理兼董事会秘书 刘磊先生 董事兼财务总监 曾小娥女士 独立董事 谢林海先生 保荐代表人 郭振国先生 证券事务代表 钟子宜先生

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、逸豪新材在2023年度的研发投入有何变化，公司在产品创新和技术升级方面有哪些新的进展？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！多年来，公司持续跟踪市场变动趋势和客户产品需求，提升产品的各项性能指标。通过多年来持续的研发和工艺改进，公司铜箔产品由常规STD铜箔持续升级演进，在产品厚度、粗糙度、抗拉性、延伸性、耐热性、抗剥离强度等性能指标上不断研发创新，目前公司已研发并批量生产HDI用超薄铜箔和105μm、140μm、175μm厚铜箔等原先依赖进口的高性能铜箔；高频高速铜箔方面，HVLPC铜箔、RTFC铜箔已向客户送样，目前正处于测试验证阶段。公司2023年研发出9μm、140μm和175μm厚铜箔产品，其中140μm和175μm铜箔目前已向客户批量供货，产品性能稳定，9μm铜箔已向海外客户送样。公司电子电路产品结构方面，超薄和厚铜箔占比进一步增大。公司铝基覆铜板产品，研发出5W高导热铝基覆铜板，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域。公司PCB产品铝基Mini LED PCB已经应用于TCL和海信的电视产品中，公司PCB已通过IATF16949汽车产品质量管理体系认证，已应用于汽车尾灯产品中，认证通过ISO13485医疗体系认证及试产。公司2024年度将着力加强适用于不同树脂体系的高频高速铜箔的研究、易剥离极薄载体铜箔的开发、6-120Z超厚铜箔的开发；铝基覆铜板方面，2024年度公司将着力于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究；PCB方面，2024年度公司将加大高阶Micro LED PCB、LED铝基“U”型PCB的技术研发。公司将利用研发成果，持续推出新产品，提升产品竞争力，加大实现高端产品进口替代的力度，进一步强化公司的核心竞争力。</p> <p>2、公司在2023年度净利润出现了亏损，请问这种亏损是由于哪些因素造成的？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！2023年度，因终端消费需求疲软，行业内新增产能较大等因素影响，铜箔行业竞争加剧，行业内铜箔加工费整体大幅下滑，报告期内公司铜箔加工费、销售单价、毛利率均大幅下滑。PCB方面，2023年度，公司PCB产能仍处于爬坡阶段，公司通过持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，报告期内公司PCB业务的产量和营收相较2022年度均取得较大幅度增长，但因公司PCB整体产能尚未达产，产能规模优势尚未体现，导致产品单位成本较高，同时公司PCB产品结构尚在优化调整中，部分目标客户在认证过程中，在上述因素的影响下，报告期内PCB业务尚未能全面实现盈利，对公司业绩仍产生负向影响。</p>
-----------------------------	--

3、面对当前的市场挑战，逸豪新材对未来一年的业绩有何预期，有哪些积极因素可能促进公司的业绩增长？

答:尊敬的投资者您好！公司将持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔生产工艺技术水平，积极推进RTF铜箔、HVLP铜箔在客户中的应用，提升铜箔盈利水平。铝基覆铜板方面，公司长期致力于铝基覆铜板技术的研发与创新，尤其在高瓦数导热产品的开发上已取得显著成果，成功研发出5W高导热铝基覆铜板，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域，公司将坚持创新驱动，进一步加大研发力度，着重于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究，以客户需求为导向，不断提升产品质量和创新突破。PCB方面，自2021年三季度开始试生产以来，尚处于产能爬坡阶段。在产能爬坡的过程中，公司持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，公司PCB业务的产量和营收均取得较大幅度增长，随着公司PCB业务的快速发展，通过客户积累以及产品应用领域向高端化的持续进阶，公司PCB业务的盈利能力将得到显著提升。

4、逸豪新材在环保和可持续发展方面有哪些新的实践或计划？

答:尊敬的投资者您好！电力是公司生产所用主要能源之一，公司完成了一期“屋顶5MW光伏发电项目”以及二期“屋顶3MW光伏发电项目”（实际装机容量将根据工程条件调节）项目已于2023年3月验收完工并投入使用。光伏发电项目采用“自发自用，余电上网”的方式消纳，正常情况下所发电量公司可以全部消纳，实现可再生资源利用，节约能源消耗的目的。该项目充分利用屋顶资源；节省峰值电费，创造经济利益；促进节能减排，打造绿色工厂；改善屋面的隔热状况，改善厂区环境舒适性。光伏项目兼具经济效益，预计节约公司约6%的生产用电。另外屋顶安装光伏，可使厂房内夏季温度下降，节约公司空调电费开支。所发电力主要供企业自用，相当于节省燃煤约1067吨，预计减少二氧化碳排放约4606吨。

5、公司在2023年度的资产负债结构有何变化，这对公司的长期发展有何影响？

答:尊敬的投资者您好！公司2023年资产负债结构详见公司2023年年度报告，公司将稳健扩大生产经营规模，确保企业财务健康和可持续发展。

6、逸豪新材2023年度营业收入较上一年度有所下降，请问导致营业收入下降的主要原因是什么？

答:尊敬的投资者您好!2023年度公司营业收入有所下降系铜箔销售价格受市场价格影响下降所致,同时公司铝基覆铜板由对外销售转向自用为主,导致铝基覆铜板销量减少。

7、请问公司在提升供应链管理和成本控制方面采取了哪些措施?

答:尊敬的投资者您好!公司在提升供应链管理和成本控制方面采取了多种措施,通过分析和改进各个业务流程,寻找并消除造成浪费和额外成本的因素,包括简化流程、减少环节、提高效率等可以降低成本的措施。公司通过对供应商、仓储和物流等环节进行效率和成本的评估,合理规划供应链网络,以提高生产运作的效率,降低物流、仓储和库存等成本;建立长期稳定的供应商关系,与供应商建立互信、互利的合作关系,降低原材料成本;采用先进的库存管理技术和方法,提高库存周转率,降低库存成本。公司还注重加强供应链风险管理,建立完善的供应链风险管理机制,对供应链的各个环节进行风险评估和监控,及时应对潜在的风险并制定应对措施,以确保供应链的稳定性和可靠性。

8、面对净利润的亏损,逸豪新材有哪些应对措施或计划来改善财务状况?

答:尊敬的投资者您好!公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额,持续提升产品质量及产品良率,补充高频高速铜箔及超薄高抗拉锂电铜箔生产能力。充分利用自产电子电路铜箔的优势,发挥垂直一体化产业链的协同效应,发展高导热铝基覆铜板相关的业务,以拓展铝基覆铜板的高端应用领域,公司持续调整PCB产品结构,优化产能配置,针对性地调整产品线,提高高附加值产品的比重,同时优化生产布局,提升产能利用率。谢谢!

9、逸豪新材在2023年度的现金流量情况如何,公司的流动性状况是否健康?

答:尊敬的投资者您好!公司2023年度现金流情况健康稳健,具体数据详见公司年度报告第十节财务报告。谢谢!

10、请问逸豪新材在提升产品竞争力和市场份额方面有哪些战略规划?

答:尊敬的投资者您好!公司致力于成为电子材料领域领先企业,实施PCB产业链垂直一体化发展战略,立足铜箔行业,公司将在现有产能规模上,持续提升超薄铜箔和厚铜箔的产量,巩固和扩大高端电子电路铜箔的市

场份额。同时随着公司募投项目“年产10,000吨高精度电解铜箔项目”的稳步实施；公司PCB业务将科技创新与新旧产业进行融合，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，另一方面主动选择发展前景良好与公司发展战略匹配的领域进行重点布局，持续创新，加强技术和人才储备。

11. 张总你好！公司上市业绩就下降亏损！希望你带领公司利用资本市场收购兼并，重组把公司做强做大来回报社会和广大投资者，谢谢！

答:尊敬的投资者您好！涉及公司相关重大事项的，请以公司公告为准。公司目前没有应披露而未披露事项。公司将持续严格遵守信息披露要求，履行信息披露义务。感谢您对公司的关心！

12. 张总你好！公司募投项目1万吨高精度电解铜箔部分生产线2023年四季度投产！现在说成2024年第二季度投产能实现吗！能提升业绩吗？公司能不能兼并！收购把公司做大做强！谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计数据，2023年我国电解铜箔新增年产能约52.3万吨，国内总计累积年产能达155.3万吨，同比增长50.19%。铜箔行业内企业新增产能的逐步释放导致目前供给增加，行业竞争加剧。今年在铜箔方面，公司将加大研发，持续提升高附加值产品的产销占比。公司募投项目正在有序实施，新增产能将稳步释放。谢谢！

13. 张总你好！公司上市过后就亏损！有没有考虑过合并或者收购其它行业进行扩充。或者打通上下游？做强做大！

答:尊敬的投资者您好！公司坚持PCB垂直一体化产业链发展战略，横向扩张铜箔产能、优化产品结构、拓展应用领域，纵向打通产业链，强化产业协同效应，公司已掌握电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB生产核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。谢谢！

14. 在PCB业务产能尚未完全释放的情况下，公司是否有计划加快产能的提升，以期尽快实现业务的盈利？

答:尊敬的投资者您好！公司PCB产能爬坡的过程中，公司持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，目前公司PCB业务的产量和营收均取得较大幅度增长，随着公司PCB业务的快速发展，通过客户积

累以及产品应用领域向高端化的持续进阶，公司PCB业务的盈利能力将得到显著提升。

15. 董事长好，请问您如何看待当前电子电路铜箔市场的竞争格局，公司将如何利用自身的优势在竞争中保持领先地位？

答:尊敬的投资者，您好！近年来国内铜箔新增产能巨大，市场竞争日益激烈，公司将在现有产能规模上，持续提升超薄铜箔和厚铜箔的产量，巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额。同时随着公司募投项目“年产10,000吨高精度电解铜箔项目”的稳步实施，该项目以生产高性能电子电路铜箔以及超薄高抗拉锂电铜箔为主。随着募投项目产能的释放，公司将大幅提升超薄铜箔、厚铜箔等高端电子电路铜箔的产能，同时也具备生产高频高速铜箔的能力；此外，公司通过研发线的中试，已掌握了4.5 μm高抗拉锂电铜箔的生产工艺技术。公司募投项目的设备及工艺，可实现电子电路铜箔和锂电铜箔切换生产，公司将加快锂电铜箔业务布局，将铜箔产品拓展至锂电铜箔领域。

16. 根据年度报告，公司在2023年的财务状况出现了一些波动，请问这是否会影响到公司未来的投资计划和发展战略？

答:尊敬的投资者您好！公司2023年财务状况符合市场趋势。公司始终坚持PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。

17. 请问公司在未来几年内，对于研发投入有何具体规划，特别是在高频高速铜箔及超薄高抗拉锂电铜箔生产能力方面的补充？

答:尊敬的投资者您好！公司今年将着力加强适用于不同树脂体系的高频高速铜箔的研究、易剥离极薄载体铜箔的开发、6-120Z超厚铜箔的开发。公司募投项目“年产10,000吨高精度电解铜箔项目”以生产高性能电子电路铜箔以及超薄高抗拉锂电铜箔为主，此外，公司通过研发线的中试，已掌握了4.5 μm高抗拉锂电铜箔的生产工艺技术。高频高速铜箔方面，HVLP铜箔、RTF铜箔已向客户送样，目前正处于测试验证阶段。

18. 鉴于公司所处的电子信息产业正在快速发展，公司将如何把握这一趋势，进一步拓展产品的应用领域和市场？

答:尊敬的投资者您好！公司高度重视产品、技术的研发和提升，在全面发展生产技术的同时，始终紧跟下游行业的发展趋势，专注于本领域的技术研发。电子电路铜箔方面，公司2024年度将着力加强适用于不同树脂体系的高频高速铜箔的研究、易剥离极薄载体铜箔的开发、6-120Z超厚铜箔的开发；铝基覆铜板方面，2024年度公司将着力于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究；PCB方面，2024年度公司将加大高阶Micro LED PCB、LED铝基“U”型PCB的技术研发。公司将利用研发成果，持续推出新产品，提升产品竞争力，加大实现高端产品进口替代的力度，进一步强化公司的核心竞争力。

19. 请问公司在财务风险管理方面采取了哪些措施，以应对可能出现的市场波动和汇率风险？

答:尊敬的投资者您好！公司已建立了完善的内部控制制度，包括公司内部管理制度、会计制度、财务制度、内部审计制度等，确保内部资金的健康安全。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系，公司相关职能部门广泛、持续收集相关的内部、外部各种信息，并对收集的信息及时进行风险评估，做到市场风险、信用风险、流动性风险、预算风险整体可控。谢谢！

20. 关于公司的长期财务健康和股东价值增长，您能否分享一些具体的财务策略和目标？

答:尊敬的投资者您好！公司通过合理的资金管理和风险控制，避免公司出现资金短缺或过度占用资金的情况。同时，公司强化现金流管理，确保公司具备充足的现金流以支持日常运营和未来发展。此外，公司非常注重债务管理，合理控制债务规模和债务成本，降低财务风险，加强内部控制，确保公司财务信息披露的准确性和完整性。

21. 年报中提到公司将巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额，那么公司在提升产品良率和质量方面有哪些具体措施？

答:尊敬的投资者您好！公司注重生产过程的优化和改进。通过持续改进生产设备和技术，提高生产工艺的自动化和智能化水平，降低人为因素对

	<p>产品良率的影响。此外，加强对生产过程的监控和管理，确保生产过程中的稳定性和可控性，及时发现并解决潜在问题，从而提高产品的良率。公司不断强化对产品的检验和测试，通过建立完善的检验和测试体系，对生产过程中的半成品和成品进行严格的检验和测试，确保产品质量的稳定性和一致性。在员工培训和管理方面，通过定期开展技术培训和质量意识教育，提高员工的技术水平和质量意识，建立健全的激励机制和考核体系，激发员工的积极性和创造力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月17日